

荏原、半導体投資3年で800億円超 研磨装置で首位目指す

2026/04/10 20:54 日本経済新聞電子版 907文字

荏原は2028年12月期までの3年間で半導体製造装置関連に800億円超を投資する。過去最大だった直近3年間と同等かそれを上回る規模となる。半導体のシリコン基板の表面を削る「CMP装置」で30年に世界首位に並ぶ目標だ。

荏原が手掛けるCMP装置はシリコン基板の表面をナノ（ナノは10億分の1）メートルレベルで平らに研磨する。半導体チップの製造ではシリコン基板上に何層にも回路を形成し、そのたびに研磨を繰り返すためCMP装置が多く使われる。

荏原の同分野のシェアは現在約3割で、約5割とされる米アプライドマテリアルズに次ぐ。

荏原はシェア拡大に向け半導体を中心とする精密・電子セグメントに過去最大規模の投資をする。細田修吾社長は「直近3年間で約800億円を投じてきた」とした上で「次の3年は同等かそれ以上の投資額を見込む」と話す。

細田社長は将来的にシェア首位を目指し「まず30年には競合と並ぶ位置につけたい」とする。半導体市場は需給の変動が大きいいため先行して生産能力を整える。

荏原がシェアを拡大できる根拠とみているのが半導体の高性能化だ。人工知能（AI）などに使う先端半導体は数ナノメートルの細い回路を基板上につくる。

荏原は競合に比べて回路上の金属配線を研磨する技術に強みを持つ。回路が微細化して密度が高まっていることが追い風になるという。

荏原は25年に熊本県南関町でCMP装置の生産棟を稼働し、神奈川県藤沢市でも開発棟を竣工した。今後の投資はこれらの設備内部の機器や人材に充てる。細田社長は28年ごろに「生産棟の追加も検討する必要があるだろう」とした。

半導体向けでCMP装置に続く主力製品であるドライ真空ポンプも増産する。半導体製造装置内でガスを吸引するのに使う部品だ。台湾や中国にそれぞれ数十億円規模を投じて新工場を立ち上げる。「顧客に近い場所で増産やメンテナンスに対応する」（細田社長）考えだ。

荏原の精密・電子セグメントの売上高は26年12月期に前期比17%増の4000億円に伸びる見通しだ。過去5年間で2倍となり、連結売上高の4割を占めるようになった。半導体市場の拡大と技術の高性能化の追い風を生かして成長を目指す。



荏原の細田社長



荏原が手掛ける半導体製造装置の「CMP装置」＝同社提供

【関連記事】

- ・ 製造業の技術継承にA I活用 慶応大学や荏原など、業界団体を設立
- ・ 荏原とI S C、ロケットエンジンの着火試験に成功 電動ポンプ搭載
- ・ 荏原「ベテラン設計者の勘」をデジタル化 ポンプ開発期間3分の2に

許諾番号NK002648 日本経済新聞社が記事利用を許諾しています。

本サービスで提供される記事、写真、図表、見出しその他の情報(以下「情報」)の著作権その他の知的財産権は、その情報提供者に帰属します。

本サービスで提供される情報の無断転載を禁止します。

本サービスは、方法の如何、有償無償を問わず、契約者以外の第三者に利用させることはできません。

Copyrights © 日本経済新聞社 Nikkei Inc. All Rights Reserved.